

Leiterplatten effizient nutzen: Neue Möglichkeiten dank CleanCut Technologie

Ansprechpartner:

Cordula Krause-Widjaja
cordula.krause-widjaja@lpkf.com
Tel. +49 (0)5131 7095-1327
Fax +49 (0)5131 7095-90

LPKF

Laser & Electronics AG
Osteriede 7
D-30827 Garbsen
www.lpkf.de

Vorstand

Dr. Götz M. Bendele (CEO)
Christian Witt (CFO)
Bernd Lange (CTO)

Aktie:

Prime Standard
ISIN 0006450000

Abdruck frei, Beleg erbeten

» [Weitere Pressemeldungen](#)



Benjamin Klingenberg

Erst seit Oktober besetzt Benjamin Klingenberg die Position des Managing Director Electronics bei LPKF Laser & Electronics. Das Unternehmen ist ihm jedoch alles andere als unbekannt, war er doch von 2000 bis 2009 bereits am Stammsitz in Garbsen beschäftigt. Nun kommt er nach neun Jahren wieder zurück und ist überzeugt von den vielen Neuentwicklungen und dem innovativen Einsatz der Lasertechnologie im Haus. Besonders angetan hat es ihm dabei die CleanCut Technologie, die einen neuen Standard für das schnelle und saubere Leiterplatten-Nutzentrennen mittels Laser setzt.

„In der Leiterplattenbearbeitung und insbesondere beim Nutzentrennen verfügt die Lasertechnologie über zahlreiche Vorteile gegenüber mechanischen Trennverfahren: äußerst geringe Materialbelastung durch quasi kontaktfreien Schnitt, minimale Ränder zu den Schnittkanten, kein Frässtaub, weitestgehend freie Geometrien sowie flexibles Design durch digitale Datenbearbeitung. In industriellen Bereichen, in denen bei Leiterplatten insbesondere minimale Baugröße, maximale Funktionsdichte und hohe Schnittkantenqualität ohne Zerspanung gefragt sind, führt an der Lasertechnik kaum ein Weg vorbei.“

LPKF hat mit der innovativen CleanCut Technologie einen weiteren Durchbruch erzielt und die beiden wichtigsten Parameter beim Nutzentrennen – Geschwindigkeit und Sauberkeit – um ein Vielfaches verbessert: Eventuelle Verfärbungen an den Schnittkanten, die bei der herkömmlichen Laserbearbeitung auftreten können, werden durch den Einsatz von CleanCut vermieden. Zusätzlich lassen sich Laser-Bearbeitungsgeschwindigkeiten in bisher nicht gekannter Dimension erreichen. Beides ist bahnbrechend im Bereich des Nutzentrennens und bietet sowohl für Leiterplattenhersteller als auch für EMS-Dienstleister einen bisher ungekannten Effizienzgrad bei höchster Schnittqualität – und damit auch neue Möglichkeiten für das Leiterplattendesign.

Auf der electronica präsentieren wir diese Technologie erstmals live mit unserem Lasersystem PicoLine 3000 ci, das speziell zur Integration in vollautomatisierte Fertigungslinien bei EMS-Dienstleistern entwickelt wurde. Höchstwertig bestückte Leiterplatten werden damit denkbar schonend bearbeitet.

Der Anwender kann nun noch kompakter bauen und Leiterplattenflächen bis in die Randbereiche ausnutzen. Durch softwaredefinierte Schneidwege und weitgehende Geometriefreiheit ist es möglich, Entwicklungen schneller und flexibler auszuarbeiten und neue Geometrien umzusetzen.

Die Ergebnisse verbessern die Zuverlässigkeit der späteren Schaltungen. Die Sicherstellung der Prozessparameter gewährleistet, dass die Leiterplatten auch den hohen Qualitätsansprüchen in der Automotive-Branche und in der Medizintechnik gerecht werden.

Dass zusätzliche Reinigungsprozesse nach dem Laserschneiden nun überflüssig sind, bietet erhebliche Kosteneinsparungen hinsichtlich des Prozessablaufs sowie des Materialaufwands.

Ich denke, LPKF hat mit den PicoLine Systemen mit CleanCut großartige Möglichkeiten für die Leiterplattenproduktion und das Nutzentrennen am Ende der Bestückungslinien geschaffen und eröffnet damit neue Optionen für diverse Technologiefelder.“

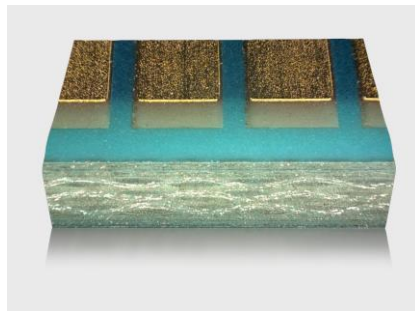


Abb. 1: Mikroskop-Aufnahme einer Schnittkante: Glatte Oberfläche, schneller Schnitt. Mit PicoLine-Systemen lassen sich die gängigen Leiterplattenmaterialien in kürzester Zeit sauber und rückstandsfrei bearbeiten.



Abb. 2: Das Lasersystem LPKF PicoLine 3000 ci ist prädestiniert für das Nutzentrennen in Fertigungslinien. Es erzeugt in kurzer Prozesszeit saubere Leiterplatten-Schnittkanten.

Über LPKF

LPKF Laser & Electronics AG produziert Maschinen und Lasersysteme, die in der Elektronikfertigung, der Medizintechnik, der Automobilindustrie und bei der Herstellung von Solarzellen zum Einsatz kommen. Rund 20 Prozent der Mitarbeiter sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt.